

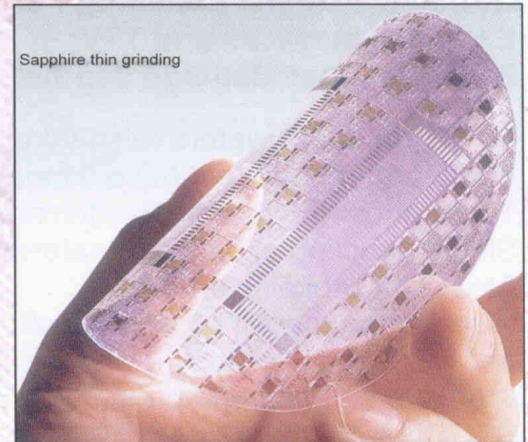
Ultradünne und dünne Silizium-Wafer

Ultragenaues Dünnen zur Zieldicke: > 30 µm kontaktlos



Vorteile / unser Angebot

- Nur Schleifen (kein Polieren), ggf. mit Trockenätzen
- Exzellente Oberflächen und TTV
- Extrem geringe Schädigungstiefen
- Bis 70 µm bei 12" Wafern (auf Anfrage auch dünner)
- Bis 60 µm bei 8" Wafern (auf Anfrage auch dünner)
- Bis 50 µm bei 6" Wafern (auf Anfrage auch dünner)
- Single Handling von ultradünnen Wafern
- Auch Solar-Orbitalwafer
- Wir arbeiten auf Maschinen mit führendem Weltstandard und höchster Technologie
- Wir haben erfahrene Produktionsleiter
- SECON Highspeed Trockenätzen

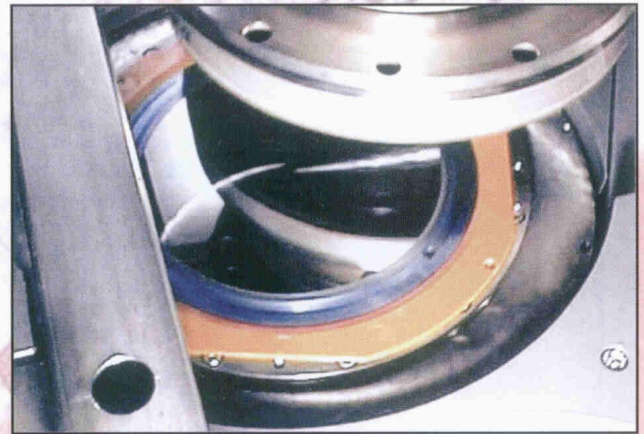


Anwendungsgebiete

Wir schleifen auf G&N NANOgrinder

Unsere Produkte werden zumeist genutzt für

- SOI - Vorbereitung
- SOI Dünnen: 8" bis 15 µm ultragenau
- MEMS
- RFID
- Stacked Wafers
- Bumped Wafers
- Bonded Wafers



Dieses Projekt wurde von der Europäischen Union (EFRE) und dem Freistaat Thüringen (TMWTA) kofinanziert.



my-Chip Production GmbH, Prof.-Hermann-Klare-Str. 6, D - 07407 Rudolstadt, Germany
Tel: +49 (0) 36 72 / 47 82 60, Fax:+49 (0) 36 72 / 47 82 65, , www.german-my-chip.com

Ultradünne Wafer/Chips - Diamant-Multi-Mikro-Draht-Säge
Verkauf von Maschinen und Clustern - Technologie-Entwicklungen - Lohnarbeiten
Silizium, Saphir, Glas, Quarz, Magnete, andere spröde Kristalle und Materialien